

논문 공모

ASE KOREA ENGINEERING SYMPOSIUM

2019년 12월 19일 (목)

제3회 Engineering Symposium

반도체 패키징을 선도하는 ASE KOREA에서는 우수 인력의 연구를 장려하고 기술향상 사례를 발굴하기 위하여 “제3회 Engineering Symposium”을 개최합니다. 반도체 패키징 관련 여러 학계, 산업계가 참가하는 이번 학술대회에 많은 관심과 참여 바랍니다.

신청자격

관련 학계 대학(원)생 및 관련 산업계 종사자

공모분야

공정 개선/PACKAGE/기술 MATERIAL 개발/ 품질 혁신 (SIP 분야 선호)

제출형식

국문 또는 영문, PPT 또는 WORD 파일

제출기한

2019년 11월 22일 (금)

제출방법

E-MAIL 접수 (jbkim@asekr.com)

심사절차

1차 - 사전심사 (12월 06일)

2차 - 현장심사 (12월 19일)

발표 일정 및 장소

2019년 12월 19일(목) 장소: ASE KOREA

최우수상 (1명, 팀) - 1000만원

우수상 (2명, 팀) - 300만원

참가상 - 30만원

문의처

ASE KOREA 인사부 (☎ 031-940-0388)